

DI Corporation

Investor Relations

June 2021



Disclaimer

본 자료에 포함된 경영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는 한국 기업회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

본 자료는 미래에 대한 “예측정보”를 포함하고 있습니다.

이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

또한 향후 전망은 현재의 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로서 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 입증자료로써 사용될 수 없습니다.



Contents

I

Corporate Overview

II

Business Area

III

Industrial Prospect

IV

New Business



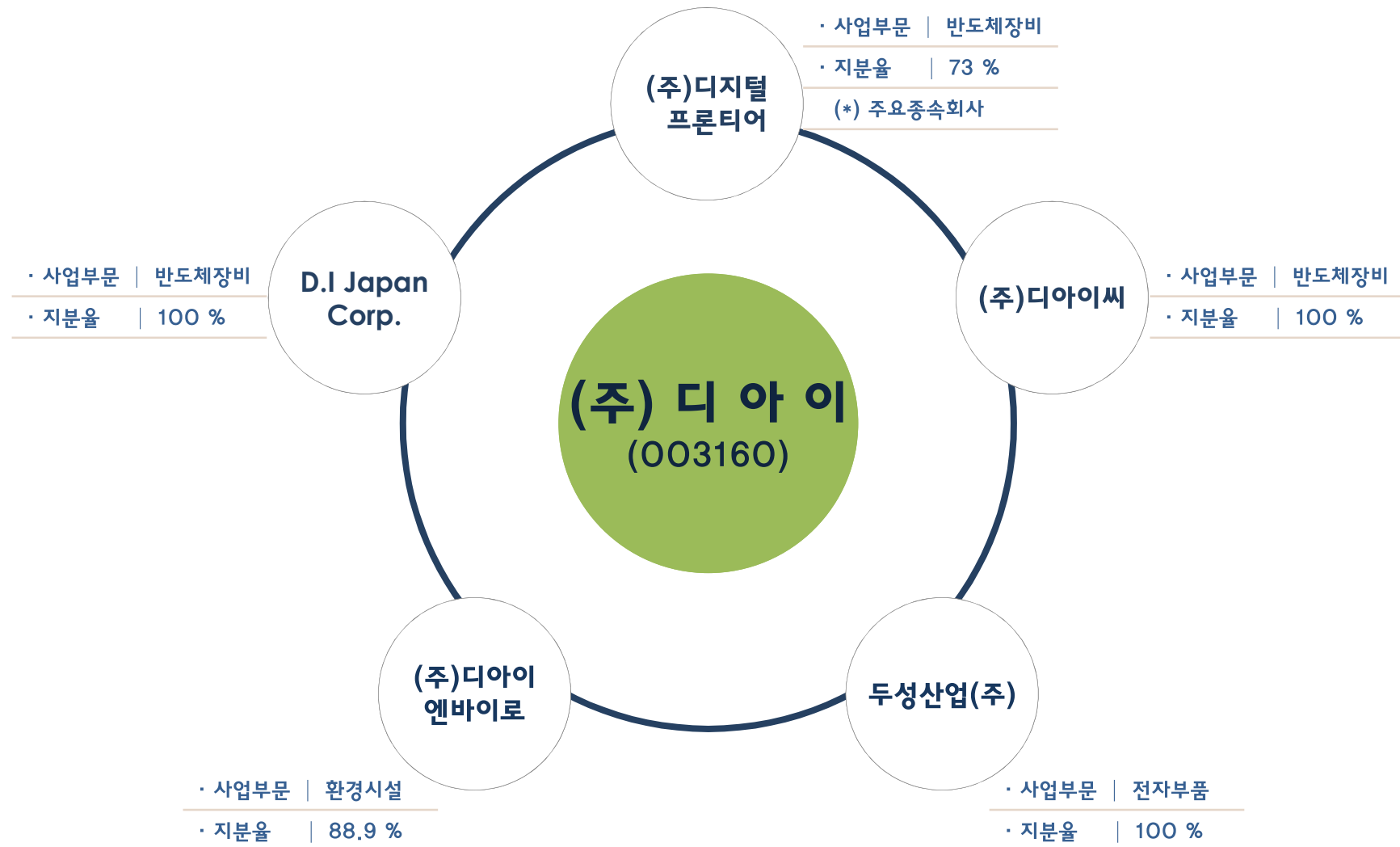
Corporate Overview

1. 회 사 소 개

2. 경 영 실 적

3. 수 주 잔 고

4. 배 당 정 책



(주) 디 아 이

대표이사	박 원 호 회 장 장 일 선 사 장
설 립 일	1961년 3월 16일 (1996년 7월 31일 상장)
임직원수	213명 ('21.3월말 기준)
주요사업	반도체 검사장비 및 부품 제조업
자 본 금	17,248,392,500 원
발행주식수	31,496,785 주
소 재 지	본사 : 서울시 강남구 논현로 703 디아이B/D 공장 : 경기도 화성시 삼성1로 3길 32 (동탄사업장)
홈페이지	www.di.co.kr

(주) 디지털프론티어 (*)

대표이사	오 성 구 사 장
설 립 일	2007년 1월 31일
임직원수	60명 ('21.3월말 기준)
주요사업	반도체 검사장비 및 부품 제조업
자 본 금	100,000,000 원
발행주식수	200,000 주
소 재 지	본사/공장 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9 엠타워지식산업센터 1301호

(*) 주요종속회사

I 1-3. 회 사 연 혁

(주) 디 아 이

2021.01	차세대 Burn-In Tester 양산기 납품 개시
2017.08	Burn-In Tester 2,000대 출하 달성
2014.02	Logic Burn-In Tester 양산기 납품
2013.05	Multi Flexibility Tester 양산기 납품
2010.12	Burn-In Tester 400호기 수출성과 달성
2007.11	제44회 무역의 날 5,000만불 수출탑 수상
2007.08	D.I China 설립 (소주 사무소)
2006.06	Burn-In Tester 세계 일류상품 선정
2006.02	‘전자수출 1,000억 달러 달성’ 기념 산업자원부 장관 공로패 수상
2005.11	제42회 무역의 날 2,000만불 수출탑 수상
2005.10	D.I Taiwan 설립 (신주 지사)
2005.09	제1회 대한민국반도체기술대상 최첨단기술상(국무총리상) 수상
2003.02	D.I Japan 설립 (동경 현지법인)
1996.07	기업공개 (거래소 상장)
1996.04	주식회사 디아이로 사명변경
1988.08	R&D Center 설립
1955.06	동일교역 설립

(주) 디지털프론티어 (*)

2021.01	경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9로 본점 이전
2019.04	SK하이닉스 기술혁신기업 선정
2018.04	ISO9001 품질경영시스템, ISO14001 환경경영시스템 인증
2017.09	고속 웨이퍼 테스터 (DF-8600) 양산기 납품 개시
2017.08	고속 번인테스터 (DF-2200) 양산기 납품 개시
2014.03	경기도 성실납세자 선정
2012.05	(주)디아이로 최대주주 변경
2008.08	반도체 검사장치 특허등록 (특허 제10-0856079호)
2008.03	기업부설연구소 설립 인가 (한국산업기술진흥협회)
2007.05	PTBI FOS-8400 발주서 수령 (구매 금액 : 49억원)
2007.04	PTBI FOS-8400 개발 장비 납품 완료
2007.01	(주)디지털프론티어 설립

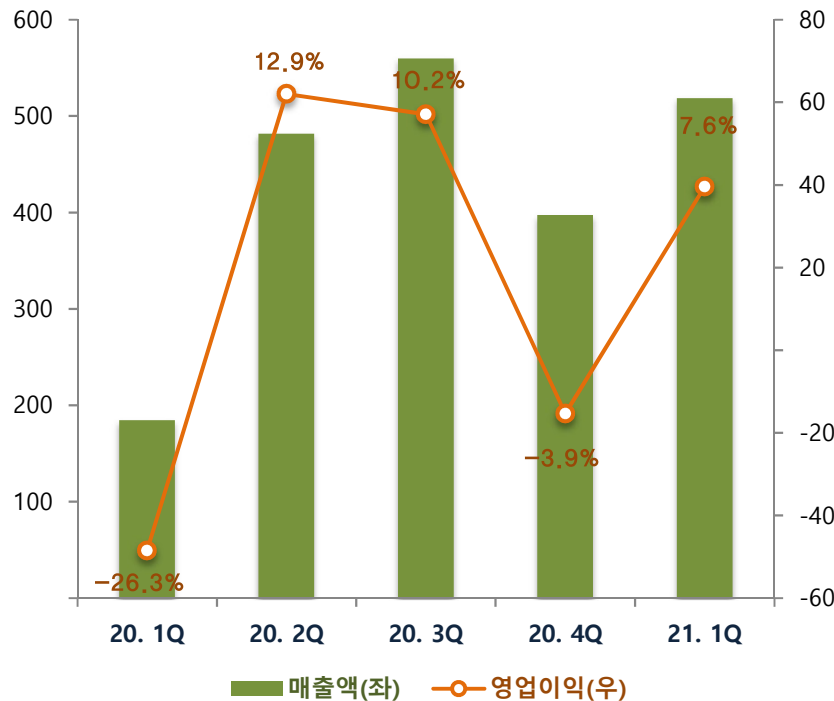
(*) 주요종속회사

전통적 비수기 극복 · 실적 성장궤도 진입

· '21. 1Q DDR5用 차세대 반도체검사장비 대규모 수주 및 양산 납품 개시

- ① 매출액 518억 (YoY +181.3%) → 역대 1분기 최고 매출액 기록
- ② 영업이익 40억 (YoY +181.6%) → QoQ · YoY 턴어라운드 달성

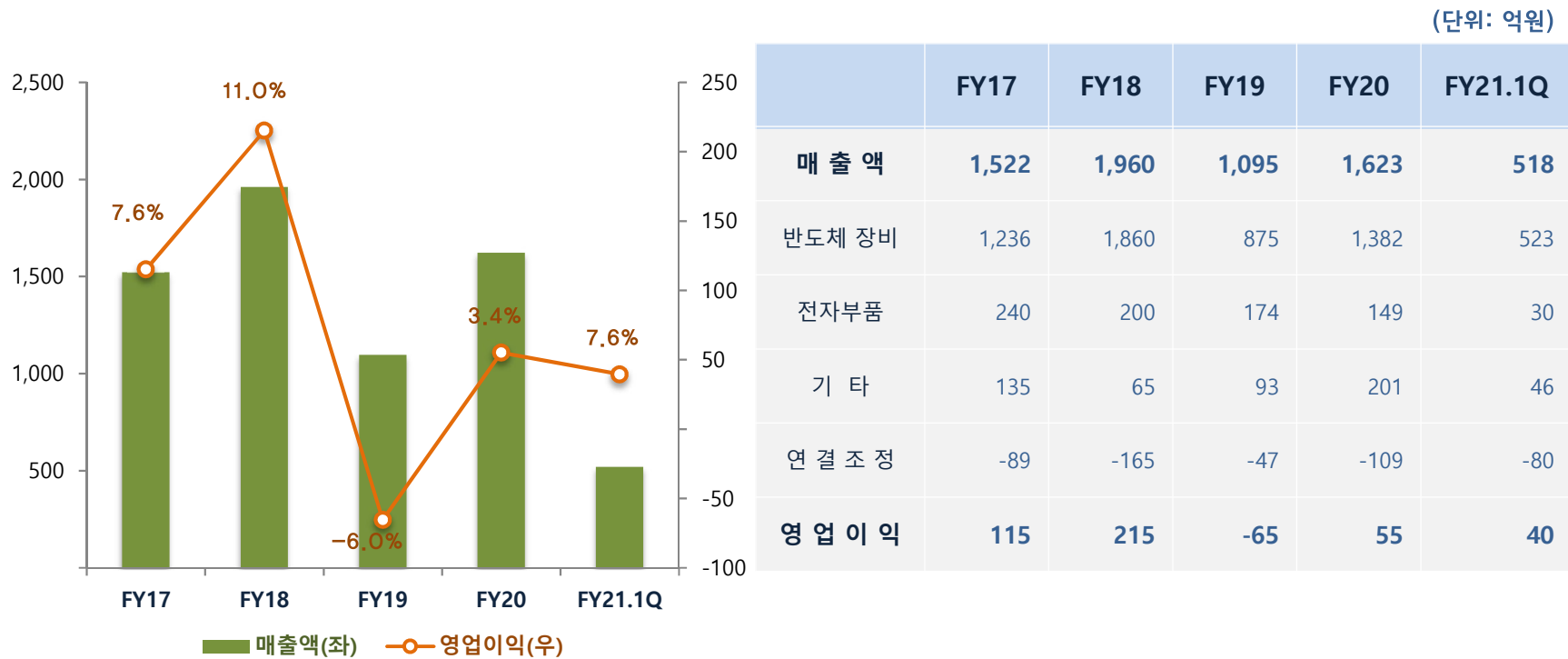
(단위: 억원)



	20.1Q	20.2Q	20.3Q	20.4Q	21.1Q
매출액	184	482	559	397	518
반도체 장비	144	413	502	322	523
전자부품	40	38	43	29	30
기 타	29	69	45	58	46
연결조정	-28	-39	-30	-13	-80
영업이익	-48	62	57	-15	40

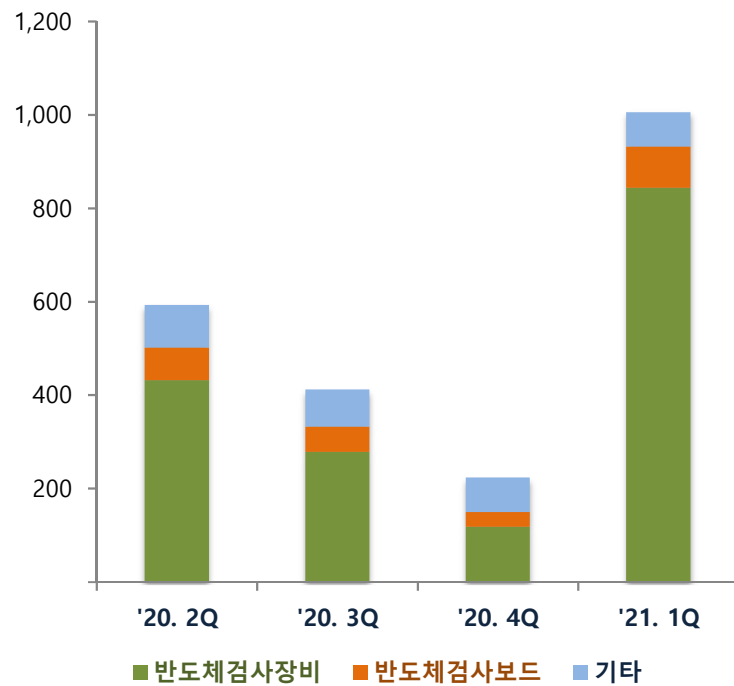
'21년 사상 최대 실적 예상

- '21. 1Q말 역대 최대 수주잔고 1,005억원 기록, 2Q~3Q 실적 확보
- 주요 고객사의 공격적인 설비투자 집행으로 사상 최대 수주 예상



수주잔고 1천억원, 실적 성장 본격화

- '21. 1Q 반도체검사장비 대규모 수주 힘입어 역대 최대 수주잔고
- '21. 2H 메모리 반도체 Top-Tier 고객사 추가투자 집행 기대



(단위: 억원)

부 문	20.2Q	20.3Q	20.4Q	21.1Q
반도체검사장비	432	279	118	844
반도체검사보드	70	54	31	88
기 타	91	80	74	73
합 계	593	412	223	1,005

공시기준 1,118 억원 수주 확보 (2021. 4. 2 현재)

NO.	계약상대	계약내용	공시 (계약)일	계약 종료일	계약금액	비고
1	삼성전자(주)	DDR5 用 차세대 BURN IN BOARD	21-01-07	21-03-12	76.6 억원	납품완료
2	삼성전자(주)	DDR5 用 차세대 BURN IN TESTER	21-01-15	21-03-31	345.3 억원	납품완료
3	삼성전자(주)	DRAM 用 BURN IN TESTER	21-01-15	21-03-31	41.1 억원	납품완료
4	삼성전자(주)	DDR5 用 차세대 BURN IN TESTER 및 NAND 用 고속 BURN IN TESTER	21-03-11	21-06-30	316.6 억원	납품진행중
5	삼성전자(주)	DDR5 用 차세대 BURN IN TESTER	21-03-30	21-08-04	286.8 억원	납품진행중
6	삼성전자(주)	NAND 用 고속 BURN IN TESTER	21-04-02	21-08-31	51.5 억원	납품진행중
		합 계			1,117.9 억원	

(*)거래소 공시기준

‘7년 연속 현금배당 실시’

· 주주가치 제고 · 장기투자 유도를 위한 지속적 배당 정책 실시

※ 과거 배당이력

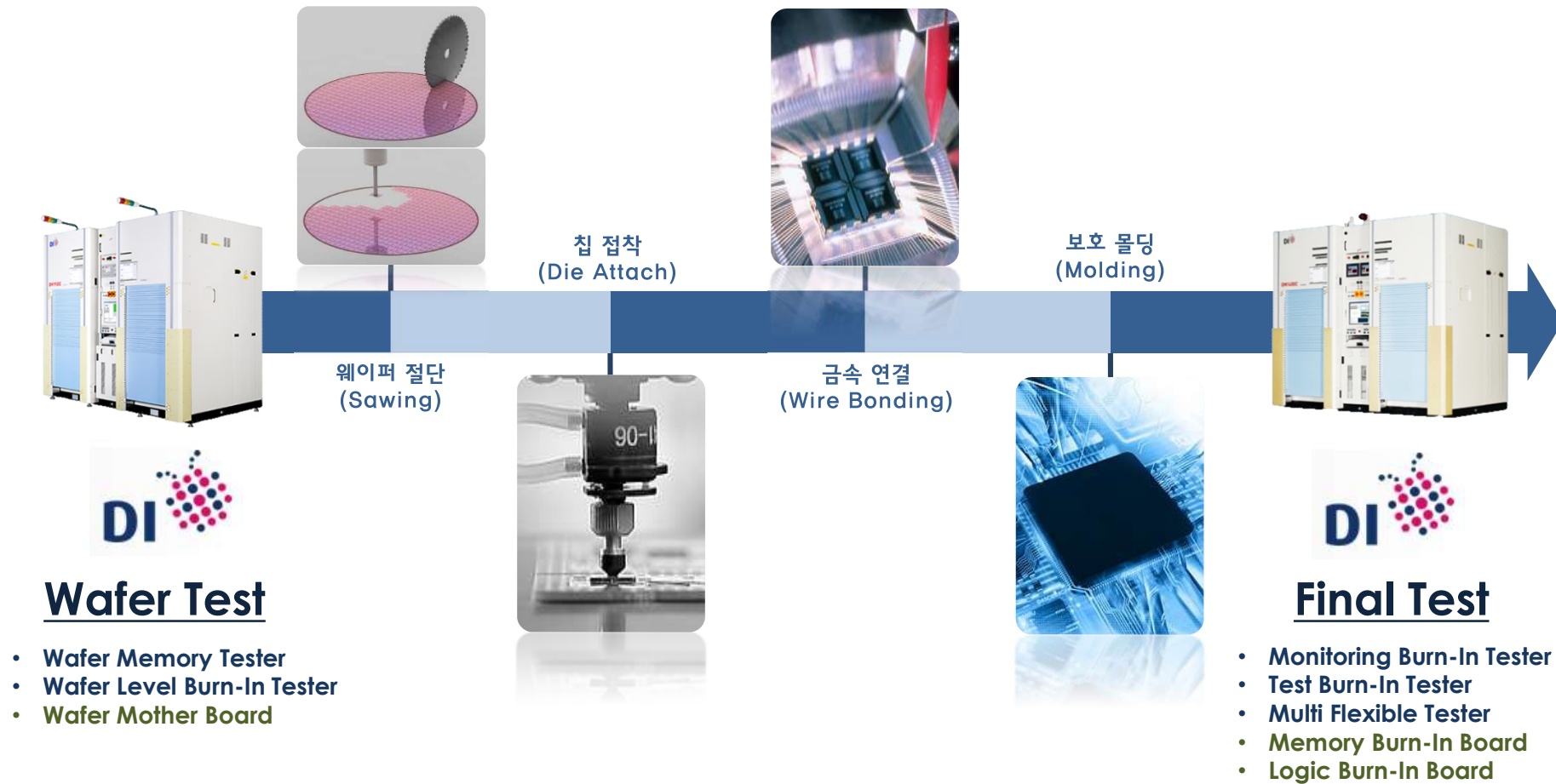
사업연도	주당 배당금	액면 배당률	시가 배당률	배당성향
2020년	100원	20%	2.3%	47.5%
2019년	50원	10%	1.6%	221.4%
2018년	50원	10%	1.4%	13.8%
2017년	100원	20%	2.0%	15.7%
2016년	50원	10%	1.1%	142.9%
2015년	50원	10%	0.8%	101.3%
2014년	75원	15%	1.1%	71.6%
연속배당 횟수		평균 배당수익률		
분기(중간)배당	결산배당	최근3년	최근5년	최근7년
-	7회	1.8%	1.7%	1.5%



Business Area

1. 사 업 분 야
2. 제 품 현 황
3. 고 객 사

반도체 후공정 (Back-End)



전(前) / 후(後) 공정 Test 제품군 보유
장비 & 보드의 Product Mix

High Speed-Multi Tester 시장 진입
Non-Memory Tester 영역으로 확장 中

Wafer Tester Group



Wafer Memory Tester



Wafer Level Burn-In Tester

Logic Tester Group



Logic Burn-In Tester



LED Burn-In Tester

Package Tester Group



Monitoring Burn-In Tester
(Domestic)

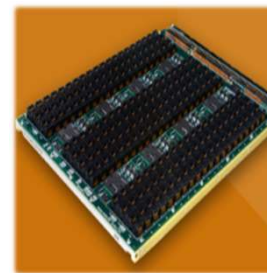


Test Burn-In Tester
(Overseas)

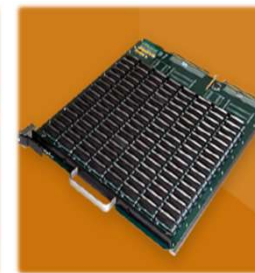


Multi Flexible Tester
(High Speed)

Boards Group



Memory Burn-In Board



Logic Burn-In Board



Wafer Mother Board

메모리 전공정 검사장비



- Wafer 단계에서의 성능 Test를 통한 수율 개선
 - Device: SDRAM, DRAM, NAND Flash 外
- SKH向 NAND用 Wafer Memory Tester 공급中
 - 기존 일본 A社 장비의 독점 영역을 침투 中
- 고객사의 국산화 정책으로 적용범위 확장 및 점유율 확대 기대

메모리 후공정 검사장비



Monitoring Burn-In Tester



Multi Flexible Tester
(High Speed)

- Package 공정 후 Cell 단위 신뢰성 Test 수행
 - Device: SDRAM, DDR, GDDR, NAND Flash, LPDDR, MCP 外
- 고속(High Speed) Burn-In 장비 양산공급 中
- SEC向 DRAM용 Burn-In 장비 1st 벤더 공급 中
NAND용 고속 Burn-In 장비 독점공급 中
- SKH向 DRAM용 Burn-In 장비 2nd 벤더 공급 中
NAND용 고속 Burn-In 장비 독점공급 中

차세대 메모리 후공정 검사장비



- 고용량/고성능의 차세대 반도체 신뢰성 Test 장비
 - Device: DDR4, GDDR6, LPDDR5, DDR5 외
- DDR5용 차세대 Burn-In Tester 시장 선점 및 양산기 납품 개시 (2021. 1월 부터~)
- '21년 현재 SEC向 대규모 수주 및 독점 공급 中
- '21년 하반기 고객사의 DDR5 양산 개시 예정으로 향후 지속적인 장비 공급 기대

비메모리 검사장비



Logic Burn-In Tester

- Endurance Test를 제공하는 고성능 장비
 - Device: DDI, SoC, Automotive, CIS 外
- 중화권 비메모리 OSAT업체에 공급 中
- SEC向 Logic Burn-In Tester 공급 中
 - 중장기 국산화 Potential

반도체 검사보드



Memory Burn-In Board



Wafer Mother Board

- 고객 Needs에 따라 다양한 설계 및 테스트 제공
 - Device: DDR, LPDDR, GDDR, NAND Flash, Logic 外
- SEC/SKH/해외 OSAT업체 등 다양한 고객사 확보

Memory Tester

Domestic



Overseas

China



Taiwan



Powerchip

WALTON

Japan



Brazil



Non-Memory Tester

DomesticOverseas

ememory

REALTEK

Qualcomm

ESWIN

Boards

DomesticOverseas

ememory

winbond
We Deliver

RENESAS



Industrial Prospect

1. D R A M

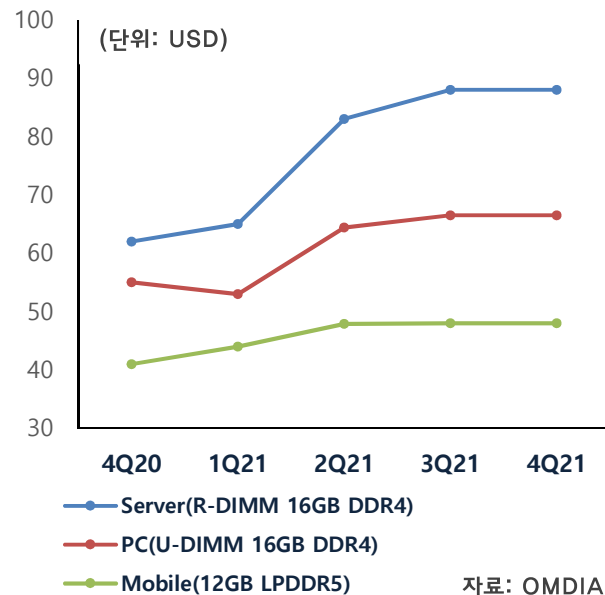
2. N A N D

3. Non-Memory

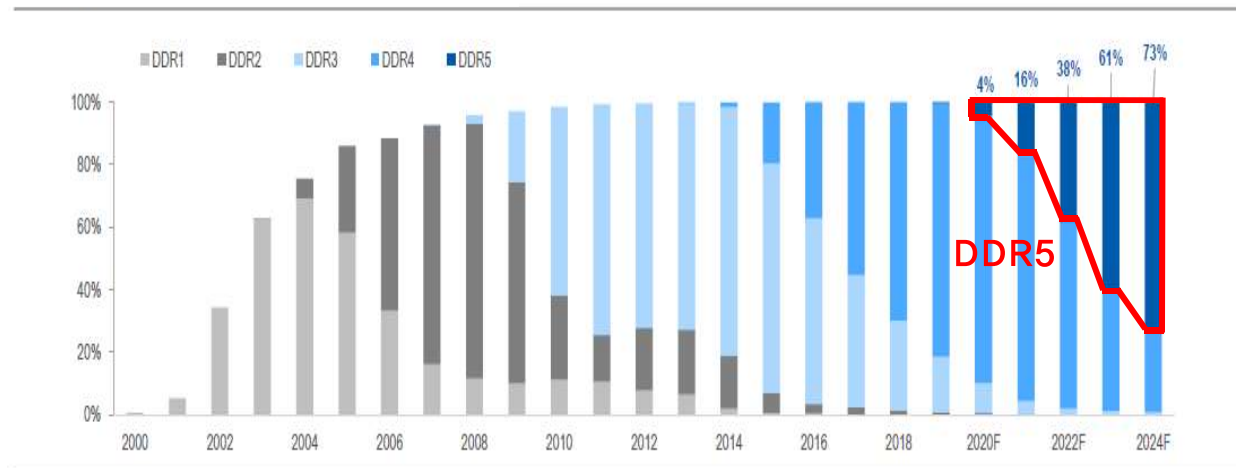
'21년 DRAM 쇼티지 · DDR5 전환 본격화

- '21년 DRAM 공급 부족 · 가격 상승세 지속 및 업사이클 진입
- 하반기 Intel의 CPU 출시 효과로 Server · PC Dram DDR5 전환 본격화 예상
- 향후 DDR5 세대 전환 가속화로 인한 차세대 검사장비 투자 확대 전망

DRAM 가격 전망



DRAM 세대 전환 추이

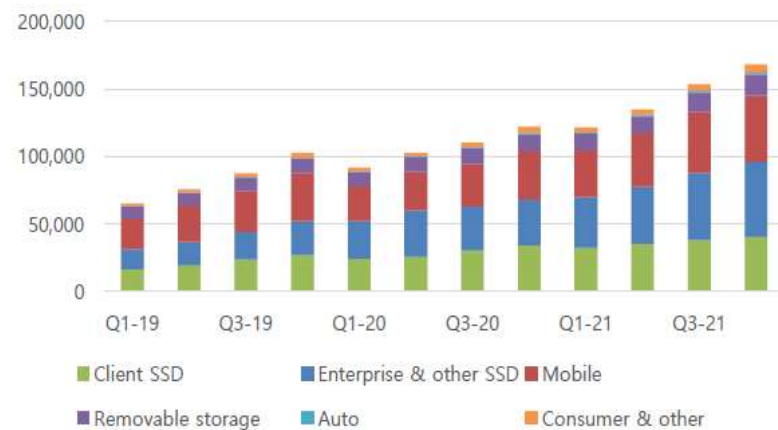


자료: 업계자료, 유안타증권 리서치센터

'21년 고단화 NAND 시장 선점 경쟁 심화

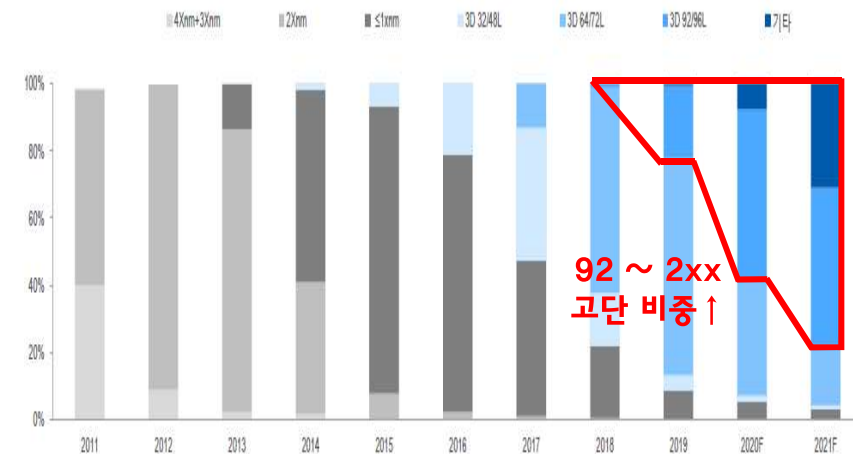
- SK하이닉스의 Intel NAND 사업 인수로 Enterprise SSD M/S 확대 기대
- 고단 NAND 양산 · 수율 확보 및 시장 선점을 위한 공격적 NAND 장비 투자 전망

어플리케이션별 NAND 수요 전망



자료: SK증권, Yole Development

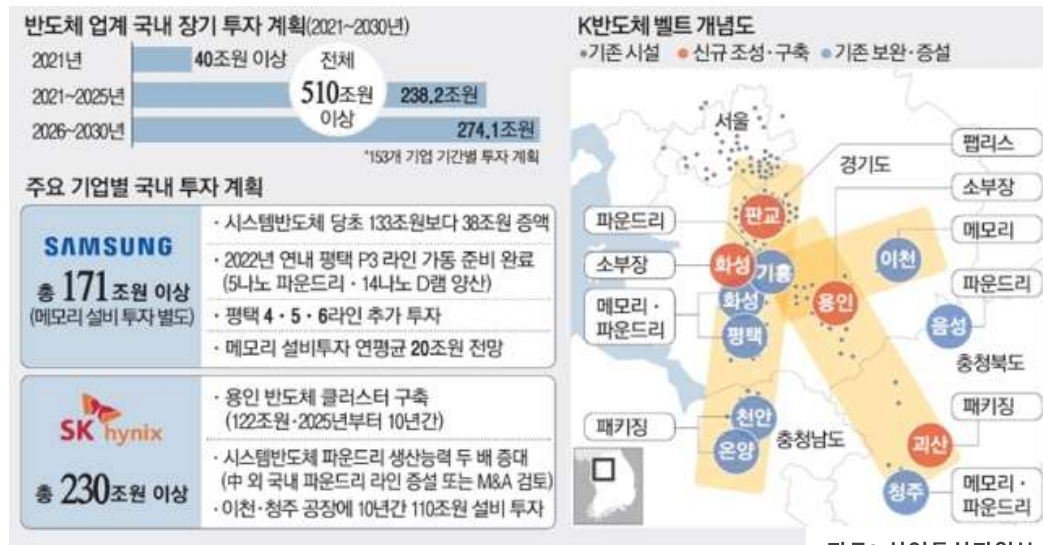
NAND 단수 변화 추이



자료: 업계자료, 유안타증권 리서치센터

한국 시스템반도체 경쟁력 중장기 성장 기대

- '21년 반도체 쇼티지發 공급망 확보 경쟁이 기업간 경쟁에서 국가간 경쟁으로 심화
- 중장기 삼성전자/SK하이닉스 파운드리 성장에 따른 비메모리 검사장비 국산화 Potential



자료: 산업통상자원부

용인클러스터 조성계획(안)



자료: 산업통상자원부

IV **New Business**

디아이, 2차전지 공정자동화 장비 신규사업 진출

- 新 성장산업인 2차전지 시장으로의 신규사업 진출
- 반도체 장비사업에서 축적된 노하우를 활용하여 2차전지 장비사업에 대한 시너지 창출
- 회사의 중장기 미래 성장동력으로 육성할 계획

[회 사 개 요]

회 사 명	주식회사 디아이비 (DIB Co., Ltd)
대표이사	반 지 혁
주요사업	2차전지 공정자동화 장비 제조업
설 립 일	2021년 6월 25일
자 본 금	1,000,000,000 원
최대주주	주식회사 디아이
지 분 율	51.0%
관 계	종속회사(연결)